

## DSS-DPS-DRR-DRS-HDS-SMAP-SMAT-SMP-SMR-SMRR-SMS-SMT-SMTE-TME

## ■取扱注意事項/Precautions

## 1. はんだ付け仕様/Soldering

(1)はんだ付け条件/Soldering Conditions

Series シリーズ名	手付け/Hand Soldering		フローライン/Auto Soldering		リフローライン/Reflow Soldering	
	はんだゴテ Solder iron		噴流式または浸漬式 Jet wave or dip type		インラインまたはバッチ式 In-line or Batch system	
	350℃ 3 sec. Max. 270℃ 5 sec. Max.	下記による	255±10℃ 3 sec. Max.	245±10℃ 3 sec. Max.	リフローは1回まで Only once	リフローは2回まで Only twice
HDS4/5		330℃ 5 sec. Max. 310℃ 7 sec. Max.				◎
DPS7/8	◎		◎			
DR2S/3S	◎			◎		
DRR3000/4000 DRR3500/3600	◎			◎		
DRR7000/8000	◎			◎		
DRS3000/4000 DRS3500/3600	◎			◎		
DRS7000/8000	◎			◎		
DSS1/2/3	◎		◎			
DSS5/6	◎			◎		
DSS7/8	◎		◎			
MGS						◎
SM2R/3R	◎				◎	
SMAP		330℃ 3 sec. Max. 310℃ 9 sec. Max.			◎	
SMAT		330℃ 3 sec. Max. 310℃ 9 sec. Max.			◎	
SMP7/8	◎				◎	
SMR5000	◎				◎	
SMR7000/8000	◎				◎	
SMRR7000/8000	◎				◎	
SMS5/6	◎				◎	
SMS7	◎				◎	
SMT1	◎				◎	
SMT3/SMTE3					◎	
SMT4		330℃ 3 sec. Max. 310℃ 9 sec. Max.				◎
TME1	◎			◎		

■取扱注意事項/Precautions

1. はんだ付け仕様/Soldering

(2)共通ランドに2端子以上はんだ付けする場合は、ソルダーレジストで独立させてください。

When soldering two or more terminals to the common land, use solder resist to solder them independently.

(3)フローラインのプリヒートは、100℃以下 30秒以内でお願いします。

Preheating : 100℃ max. 30 sec. max.

(4)リフローラインにおける温度プロファイルは、プリント基板の大きさ・厚さおよび材質等により変化しますので事前にご確認のうえ条件設定をしてご使用ください。

尚、スイッチ表面温度が240℃以上にならないよう温度管理してください。

Temperature profile on the reflow soldering bath should be determined on and adjusted in accordance with the PC board size/dimensions and material.

Also, temperature control should be made so that the switch surface temperature does not exceed 240℃.

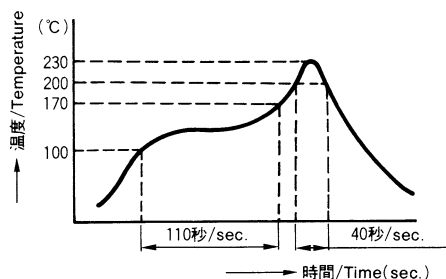


Fig.1.リフローライン

(5)はんだ付け時のローター位置について

ディップロータリスイッチにおける、はんだ付け時のローター位置は、納入時のローター位置(裏コードの10ステップはローター位置「9」、裏コードの16ステップはローター位置「F」、表コードの10ステップおよび16ステップはローター位置「0」)で、はんだ付けして下さるようお願い致します。(下表参照)

Rotor position at soldering

When dip rotary switches are soldered, the rotor positions shall be kept at the same positions as at the delivery. (See the table below.)

● はんだ付け時のローター位置  
Rotor position at soldering

	10 ステップ/Positions	16 ステップ/Positions
表コード Real code	○	○
裏コード Complementary code	9	F

2. 洗浄仕様/Flux Cleaning

(1)溶剤は、フッ素系又はアルコール系のものでご使用ください。

有機溶剤での洗浄はできません。

その他の洗浄液(水、クリンスルー、パインα等)での洗浄は保障できません。

Use fluorine-based or alcohol-based solvents.

Do not use organic solvents. If the switches are washed with other solvents such as aqueous solvents, we cannot guarantee the performance and quality of those switches.

(2)はんだ付け後洗浄する場合は、端子部温度が90℃以下で洗浄してください。

Cleaning shall be made when terminal temperature falls to 90℃ or lower.

(3)丸洗い洗浄およびシャワー洗浄をする場合は、洗浄液の温度は43℃以下で行なってください。

洗浄時間については、洗浄条件により洗浄液が浸入する場合がありますので、事前にご確認の上、条件を設定してご使用ください。

Washing solvent of 43℃ or lower shall be used for immersion cleaning or shower cleaning.

Washing time shall be determined properly.

(4)超音波洗浄はできません。(HDS4シリーズを除く)

超音波によりスイッチの気密性や接触機構に悪影響を及ぼしますので、超音波洗浄は避けてください。

Do not apply ultrasonic cleaning. Ultrasound affects and damages the airtightness and contact mechanism of the switch.

(5)はんだ付け作業直後および洗浄作業直後のスイッチ操作は避けてください。

Do not operate the switch during soldering and cleaning.

(※1.) DPS7およびSMP7シリーズは、丸洗い洗浄ができませんので、プリント基板洗浄が必要な場合は、下記条件によりシャワー洗浄を行ってください。

溶 剤 ……フッ素系またはアルコール系

洗浄条件 ……温度:37.8℃以下

時間:5分以内

■取扱注意事項/Precautions

非洗浄品 Not washable	DPS8 DSS1/2 DSS6 DSS8 HDS5 SMP8 SMS6 SMT3 SMT4
丸洗い洗浄 及び シャワー洗浄 (スプレー洗浄) 対応品 Immersion washable or shower (spray) washable	DR2S/3S DRR3000/4000 DRR3500-1A DRR3600-1A DRR7000/8000 DRS3000/4000 DRS3500-1A DRS3600-1A DRS7000/8000 DSS3 DSS5 DSS7 HDS4 MGS SM2R/3R SMAP SMAT SMR5000 SMR7000/8000 SMRR7000/8000 SMS5 SMS7 SMT1 SMTE3 TME1
シャワー洗浄 (スプレー洗浄) Shower (spray) washable (※1.)	DPS7 DSMP7

3. スイッチ操作およびテープ貼り付けについて  
Switch Operation and Taping

(1) スイッチ操作について

Switch operation

●ディップスライドの場合

(HDS、DSS、SMS、DPS、SMPシリーズ)

……操作はピンセット、ボールペン等で行なってください

Dip slide types: Use tweezers or tip of ball-point pen for operation.

●ディップロータリーの場合

(DRS、DRR、SMR、SMRRシリーズ)

……操作はドライバーで行なってください。

Dip rotary types: Use driver tip for operation.

(2) テープが貼り付けてありますので、フラックス洗浄はそのまま行なってください。

Flux cleaning should be done without removing the tape.

(3) テープをはがして再度貼り付けると、粘着力が弱くなり、フラックス流入の原因となります。

If the tape is removed, it adheres less than before when it is placed back on, possibly causing flux inflow.

■スイッチ特性表の見方

How to see The Switch Diagrams

